

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 11 月 19 日(19.11.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/174375 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/34 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
B24B 37/20 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/063500
- (22) 国際出願日: 2015 年 5 月 11 日(11.05.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-100384 2014 年 5 月 14 日(14.05.2014) JP
特願 2015-048837 2015 年 3 月 11 日(11.03.2015) JP
- (71) 出願人: 株式会社 荏原製作所(EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 末政 秀一(SUEMASA, Shuichi); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社 荏原製作所内 Tokyo (JP). 篠崎 弘行(SHINOZAKI, Hiroyuki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社 荏原製作所内 Tokyo (JP). 小林 裕(KOBAYASHI, Yutaka); 〒

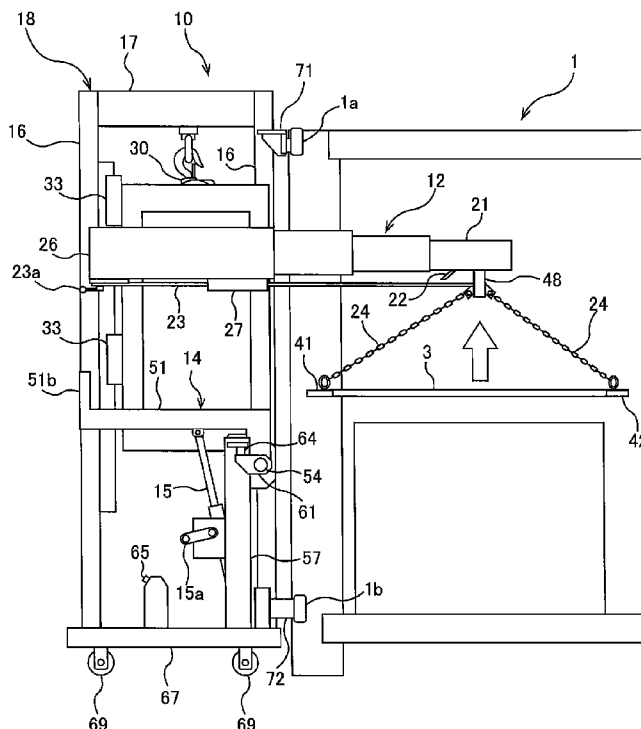
1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社 荏原製作所内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 渡邊 勇, 外(WATANABE, Isamu et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,

[続葉有]

(54) Title: POLISHING TABLE REPLACEMENT APPARATUS, METHOD FOR REPLACING POLISHING TABLE, AND DEVICE FOR REPLACING CONSTITUENT PART OF SEMICONDUCTOR DEVICE PRODUCTION APPARATUS

(54) 発明の名称: 研磨テーブル交換装置、研磨テーブルの交換方法、および半導体デバイス製造装置の構成部品を交換する装置



(57) Abstract: Disclosed is an apparatus for replacing a polishing table that is used in a polishing apparatus for polishing substrates such as wafers. This polishing table replacement apparatus (10) is an apparatus for removing a polishing table (3) from a polishing apparatus (1). This polishing table replacement apparatus (10) is provided with a crane (12) for moving the polishing table (3) in the vertical direction and horizontal direction, a table stage (14) on which the polishing table (3) is carried, and a table stage tilting mechanism (15) for tilting the table stage (14) with respect to the horizontal direction.

(57) 要約: ウェーハなどの基板を研磨する研磨装置に使用される研磨テーブルを交換するための装置が開示される。研磨テーブル交換装置(10)は、研磨テーブル(3)を研磨装置(1)から取り出すための装置である。この研磨テーブル交換装置(10)は、研磨テーブル(3)を鉛直方向および水平方向に移動させるクレーン(12)と、研磨テーブル(3)が載置されるテーブル台(14)と、テーブル台(14)を水平方向に対して傾けるテーブル台傾動機構(15)とを備える。



MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, 添付公開書類:
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).